

广州广合科技股份有限公司
关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，产品主要应用于服务器等中高端应用市场。基于深化全球战略布局的需要，经公司充分研究论证，拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

2025 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。

截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

根据相关规定，公司本次发行并上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。本次发行并上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日